



△6	△4	178306-5
△6	△3	178306-3
△6	△2	178306-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)

推奨基板取付け寸法
PC 基板厚: 1.6 ± 0.1 (非累積公差) (コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ± 0.1 (NOT ACCUMULATE TOLERANCE) (CONNECTOR MOUNT SIDE)

- NOTES
- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.38 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 0.76 μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
 - FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
 - FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- 注記
- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂
コネクタ: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
 - めっき: コネクタ: 全面Ni下地
接触部: 0.38 μm MIN金めっき
 - めっき: コネクタ: 全面Ni下地
接触部: 0.76 μm MIN金めっき
 - めっき: コネクタ: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
 - めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部
: ニッケル下地の上に半田めっき
 - めっき: リテンションレグとコネクタ半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき

Copyright © 1995 AMP(Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.				Tyco Electronics Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan				
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME				
B1 REVISED ECR-07-013273 TS DM 11 JUN 95		-		12 POS DOUBLE ROW HORIZONTAL HDR ASS'Y FOR DYNAMIC 3100				
B REVISED(FJD0-0039-03) TS S.M 6/2 '03		SEE NOTE 注記参照		GENERAL TOLERANCE		SIZE	LOC	NUMBER
A REVISED(FJD0-0114-03) TS SM 25 APR '03		SEE NOTE 注記参照		10% ±0.3		A3	J	C-178306
O RELEASED FJ00-2528-95 NM Y.I 6/30 '95		DR. 23 JUN 95 N. Matsubara		10% ±0.4		SCALE		REV.
LTR REVISION RECORD DR CHK DATE		CHK. 30 JUN 95 Y. ISHIKAWA		30% ±0.45		2-1		B1
		APP. 3 JUL 95 S. MANABE		角 度 ±3'		SHEET		1 OF 1